

**Dk 4.0 Df 0.013
@10GHz**

Tg(DSC) 170°C

**无卤素
无铅焊接**

**应用
网络**

ICT基础设施设备, 测量仪器等

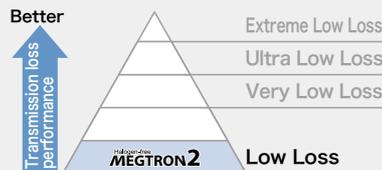


Halogen-free
MEGTRON2

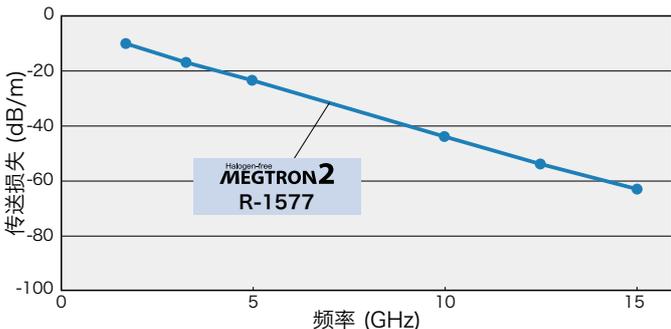
芯板 半固化片
R-1577 R-1570

无卤素低传送损失·高耐热性多层基板材料

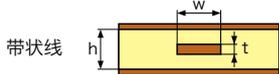
高 Tg 无卤素基板材料, 适用于
高速低传送损失, 大容量数据
传输产品



传送损失对比



叠构



线宽 (w)	0.1mm
线路高度, 线路厚度 (t)	0.035mm
介电层厚度 (h)	0.28mm
芯板	0.13mm
半固化片	0.06mm x 2ply
线路长度	1m
阻抗	50Ω

高多层耐热性

结果

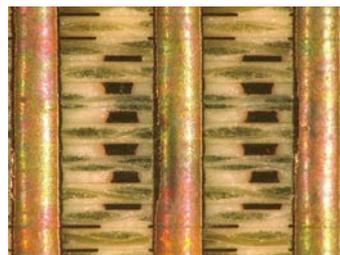
孔径	φ 0.3mm		
通孔壁间距离	0.5mm	0.6mm	0.7mm
Halogen-free MEGTRON2	合格	合格	合格

条件

260°C回流焊×10次

叠构

28层
板厚: 3.8mm



一般特性

项目	试验方法	条件	单位	Halogen-free MEGTRON2 R-1577	
玻璃态转化温度(Tg)	DSC	A	°C	170	
热膨胀系数(Z-轴方向)	IPC-TM-650 2.4.24	A	α1	34	
			α2	200	
T288(含铜)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分钟	25	
介电常数(Dk)	IPC-TM-650 2.5.5.5	C-24/23/50	—	4.0	
介质损耗因数(Df)				0.013	
铜箔剥离强	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	1.3 [ST]

试验片厚度为0.8mm。

在使用本产品时, 请在我公司网站上确认注意事项。

industrial.panasonic.com/ea/electronic-materials

松下电器机电 MEGTRON2

本公司的无卤素材料基于的是JPCA-ES-01-2003等的定义。
上述数据为本公司测量所得的代表值, 非保证值。

松下电器机电(中国)有限公司

© Panasonic Industry (China) Co., Ltd. 202503